

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

杭州美迪凯光电科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	网上投资者
时间	2025 年 5 月 27 日 9:00-10:00
地点	上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：葛文志 副总经理兼董事会秘书：王懿伟 副总经理兼财务总监：华朝花 独立董事：韩洪灵
投资者关系活动主要内容介绍	Q1：贵公司上市以来就连续两年亏损，随着产品的逐步量产，营收在增长，但各项费用也大幅增加，请问公司有什么措施来降本增效，早日扭亏为赢。谢谢。 答：尊敬的投资者，您好！随着公司新产品陆续量产，主营业务收入增加，公司盈利状况有望逐步好转。2025 年一季度公司净利润虽仍为负值，但亏损同比收窄。公司将积极推进新产品的研发和量产，提高公司设备利用率，促进毛利率增长，努力提升公司的盈利能力。感谢您的关注！ Q2：公司考虑过如何做大做强，公司的发力点在哪里？ 答：尊敬的投资者，您好！公司在考虑如何做大做强方面，主要发力点在于以现有核心技术和优质客户资源为基础，把握行业发

	展机遇，巩固在光学光电子及半导体声光学领域的业务优势，同时积极拓展半导体晶圆制造及半导体封测领域，以科技创新为核心驱动力，发展半导体行业的进口替代业务。具体体现在： 1. 业务拓展与优化：公司投资多个业务领域，包括半导体声光学、半导体微纳电路（主要为 MEMS）、半导体封测、AR/MR 部品、精密光学、微纳光学等，旨在优化业务与收入结构、客户结构，完善半导体器件产业链上下游布局，进而提升抗风险能力。在半导体声光学领域，公司着力推进超声波指纹芯片、图像传感器光路层等产品的研发与量产；在半导体微纳电路及封测方面，已实现 SAW 滤波器晶圆的批量生产；在半导体功率器件封测上，加大对超高功率封装系列的投入并实现量产；在 AR/MR 光学零部件领域，与大厂紧密合作实现产品的量产出货；在精密光学和微纳光学领域，也取得了相应的产品开发与量产成果。 2. 技术研发与创新：公司始终将自主研发能力建设置于战略核心地位，构建起“研发投入 - 技术突破 - 价值转化”的创新闭环体系，不断推动核心技术的更新与迭代，并取得了显著成果。在半导体声光学领域，开发了多通道色谱芯片整套光路层加工工艺、MicroLED 全流程工艺技术、Metalens 工艺以及多通道色谱芯片光路层工艺等；在半导体微纳电路领域，开发了射频芯片 BAW 滤波器生产等工艺；在半导体封测领域，自主研发了真空塑封等技术；在精密光学和微纳光学领域，也取得多项工艺技术突破。此外，公司持续加大在 MicroLED 全彩方案等多方面的研究开发力度，不断加大研发投入，培养专职研发人员团队，积极申请和获取境内外专利。 感谢您的关注！ Q3：随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，给美迪凯的业务带来了哪些机遇和挑战？ 答：尊敬的投资者，您好！人工智能、物联网等新兴技术的快速
--	---

	发展为公司带来了广阔的市场机遇。例如，公司开发的 AR/MR 高折射玻璃晶圆、匀光片、光学微棱镜等产品，满足市场对高端光学产品的需求。公司利用自主研发半导体声光学技术、半导体封装测试技术，为客户提供了定制化的超小型化、高精度、高性能的芯片模组和封装测试解决方案，有望充分受益于物联网行业对各类传感器需求的爆发式增长。同时，公司也将积极应对行业竞争加剧、技术迭代等挑战，不断提升自身的技术实力和产品竞争力，以适应市场的发展变化。感谢您的关注！ Q4：您好，请问公司今年有扩展其他业务的打算吗？ 答：尊敬的投资者，您好！公司立足于目前主营业务，坚持产品差异化策略，积极完善业务和产品结构，投资布局半导体声光学、半导体微纳电路（主要为 MEMS）、半导体封测、AR/MR 部品、精密光学、微纳光学及智慧终端制造等业务。 2025 年，公司技术研发将围绕“巩固优势、突破前沿、储备未来”三层次战略布局：在半导体声光学、微纳电路及先进封测、精密光学等领域持续深化工艺创新，筑牢技术护城河；加速 TGV（Through Glass Via）工艺、Metalens 及多通道色谱芯片光路层等关键技术攻关，推进差异化产品落地，同步推进专利布局与研发成果转化。感谢您的关注！ Q5：高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！在光学领域，纳米级镀膜精度控制、超透镜结构设计及多光谱成像系统集成等关键技术加速迭代，赋能 AR/VR 设备、车载激光雷达等新兴场景的规模化应用。半导体行业则通过三维集成电路堆叠、玻璃通孔技术等工艺创新，突破射频前端模块与先进封装的技术瓶颈。今后技术交叉融合将持续深化，Metalens、TGV、MicroLED、多光谱芯片、光子芯片等前沿技术有望实现规模化应用；车载激光雷达与 AR 设备将推动消费与工业场景的智能化革命；低空经济、元宇宙等新兴领域将催
--	---

	生万亿级市场机遇。面对挑战，企业需强化跨学科研发能力、加速专利布局，并在生态协同中构建可持续竞争力。感谢您的关注！ Q6：公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，这对投资者的信心有一定影响？公司如何加强投资者关系管理？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度不分红主要是基于公司目前的经营发展资金需求和亏损状况考虑，目的是为了保持公司的稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司将力争通过业绩增长等方式，为投资者创造更大的价值。感谢您的关注！ Q7：请介绍公司年产 20 亿颗（件、套）半导体器件项目的建设进展情况，谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！本项目计划建设两栋主厂房（FAB 厂房和半导体封装厂房）、一栋测试中心、一栋试验中心、一栋食堂及配套用房、一栋动力中心和一栋甲乙类仓库等。截至当下，项目工程建设按计划有序开展，各建筑单体主体均已完工，整个建筑工程预计于 2025 年 6 月完成竣工验收。后续，公司将进一步加强项目管理、加大统筹力度，保障项目按计划顺利推进。感谢您的关注！ Q8：请问，公司的精密光学元件可应用于 AR 眼镜和机器人吗？ 答：尊敬的投资者，您好！公司高折射玻璃晶圆已实现量产，主要用于 AR/MR 眼镜。此外，公司量产的微纳光学产品也有应用在扫地机器人上。感谢您的关注！ Q9：公司今年一季度营收增长了 29.02%，能否详细介绍一下各业务板块的增长情况及未来增长潜力？ 答：尊敬的投资者，您好！2025 年一季度公司营业收入 1.49 亿元，同比增长 29.02%。其中半导体声学产品、半导体封测产品
--	---

	等增长明显。未来，随着产品的不断放量及新产品研发和量产，以及市场对光学光电子和半导体产品需求的持续增长，公司各业务板块有望继续保持良好的增长态势，为公司整体营收和利润的提升提供有力支撑。感谢您的关注！ Q10: 美迪凯的核心管理团队在行业内拥有丰富的经验，公司如何确保管理团队的稳定性和持续创新能力？ 答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视核心管理团队的稳定性和持续创新能力，采取了一系列措施。在激励机制方面，公司实施了股权激励计划，将核心管理人员和关键技术骨干的利益与公司发展紧密绑定，充分调动了他们的积极性和创造性。同时，公司还为管理团队提供了良好的职业发展空间和培训机会，鼓励他们不断学习和进步，提升自身的专业素养和管理水平。此外，公司还注重企业文化建设，营造了良好的工作、生活氛围，增强了团队的凝聚力和向心力。感谢您的关注！ Q11: 公司在拓展海外市场订单方面有什么进展吗？ 答：尊敬的投资者，您好！面对市场环境的变化，公司在稳固现有客户的同时，坚持“国内深耕”与“海外拓展”双线并进：一方面强化国内业务布局，聚焦通信和消费电子、智能汽车等领域，持续推进核心器件的国产化替代，加强与重点客户的深度合作，提升快速响应能力；另一方面加速开拓海外市场，细分欧美、日韩等区域，强化相关业务部门，通过组建本地化团队，推动与目标客户的深入交流与合作。通过优化全球客户网络布局，公司同步构建跨区域协同机制，依托国内总部与海外中心的联动，强化市场动态跟踪与资源调配能力，持续提升国内外市场的渗透效率与抗风险水平。感谢您的关注！
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 5 月 27 日

